

### 【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an uneven thickness of solder resist due to recessing of coated solder resist or uneven coating of solder resist (Solder resist curing process)

## 2-3-1-8 鉄基板 SR 傷／鉄基板的 SR 划伤 / Scraped solder resist on iron-base printed board

【特徴】 幅広く S R が削り取られている状態の欠陥、露出部の鉄表面に錆が見られる

【特征】 SR 被大面积削掉的缺陷, 露出部位的铁氧化。

【Characteristics】 Solder resist is widely scraped off. The exposed iron-board surface is often rusted.

【原因・判断ポイント・発生工程】 鉄基板製品が重なり装置に挟まるなどにより、S R 部が削り取られたりして出来たもの (S R 塗布工程後)

【原因、判断要点、发生工序】 由于铁基板重叠, 被夹在装置里, SR 部位被削掉所引起的 (SR 涂布工序后)。

### 【Causes/processes involved/keys to judgment】

Iron-base printed boards are stacked or pinched in the machine and solder resist is scraped off to cause the defect. (After solder resist application process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

## 2-3-2 その他 (SR その他欠陥) / 其它 (SR 及其它的缺陷) / Other solder resist related defects

### 2-3-2-1 SR 被り / SR 爬上导线 / Solder resist left on conductor to be exposed

【特徴】 S R が、導体上に部分的に被っている状態の欠陥、同一個所欠陥となることが多い

【特征】 SR 爬上导线局部的缺陷, 大多数是定位性的缺陷。

【Characteristics】 Solder resist covers partially on the conductor to be exposed. Often the defect occurs on the same position of all the products.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 印刷版裏の汚れや A W F のピンホールなどにより出来たもの (S R パターン印刷、焼付露光工程)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×